

SP-3500R



## ・特徴

使用できる基材の寸法は2インチ以下ですが、3個のターゲットを持っており、多層膜の連続成膜が可能です。スパッタリング用電源を追加する事により、複数ターゲットの同時使用が可能で、複合材の成膜が出来ます。酸素ガスの導入による反応性スパッタリングが可能です。

## ・仕様

到達圧力	×10 <sup>-4</sup> Pa 台※常温・無負荷・脱ガス時
排気速度	×10 <sup>-4</sup> Pa 台迄 20分以内※常温・無負荷・脱ガス時
成膜室径	φ430mm×300mmH SUS304 電解研磨
スパッタ用電源	RF 電源 13.56MHz 500W 自動マッチング 1台
基板形状	2インチ 1枚
膜厚分布	±15%以内
ターゲット寸法	3インチ(金属・絶縁物)
ターゲット個数	3
基板回転	無し
基板加熱	常温～400℃迄昇温可能
真空排気系	油回転ポンプ：350L/min 油拡散ポンプ：1200L/sec
操作方法	手動
ガス系統	マスフローコントローラ 2系統
ユーティリティ	電気：AC200V 三相 5KVA 冷却水：25L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25℃以下循環 計装エア：0.5MPa 以上 設置寸法：3000mmW×2000mmD×1800mmH